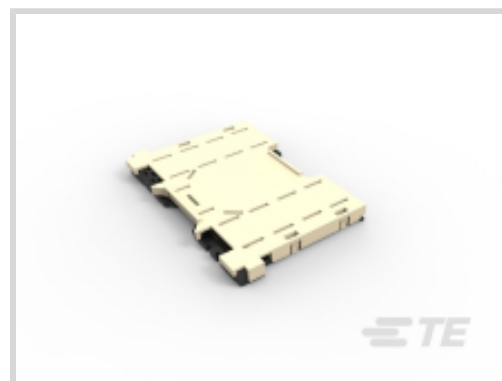




连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > LGA 插座 > LGA 3647 Sockets



IC 插座类型: LGA 3647

位数: 1824

端子接合区域电镀材料厚度: [30 μin]

中心线 (间距) : .86 mm, .99 mm [.034 in, .039 in]

PCB 端接方法: 表面贴装 - 焊球

[所有 LGA 3647 Sockets \(0\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	1824
栅格间距	.9906 x .8585 mm [.039 x .0338 in]

主体特性

框架种类	C 形
------	-----

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子基材	铜合金
IC 插座类型	LGA 3647
	30 μin
端子额定电流 (最大值)	.5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装 - 焊球
----------	-----------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
壳体颜色	黑色
中心线 (间距)	.86 mm, .99 mm [.034 in][.039 in]

使用环境

工作温度范围	-25 – 100 °C [-13 – 212 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

托盘颜色	黑色
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

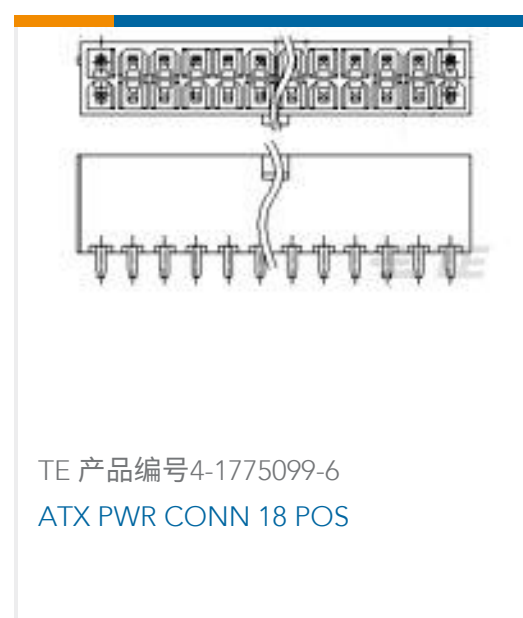
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

[LEFT SIDE LGA3647-1 SOCKET-P1 FOR ODM](#)

[英文版本](#)

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2129710-7_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2129710-7_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2129710-7_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LGA 3647 Socket Product Flyer](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本